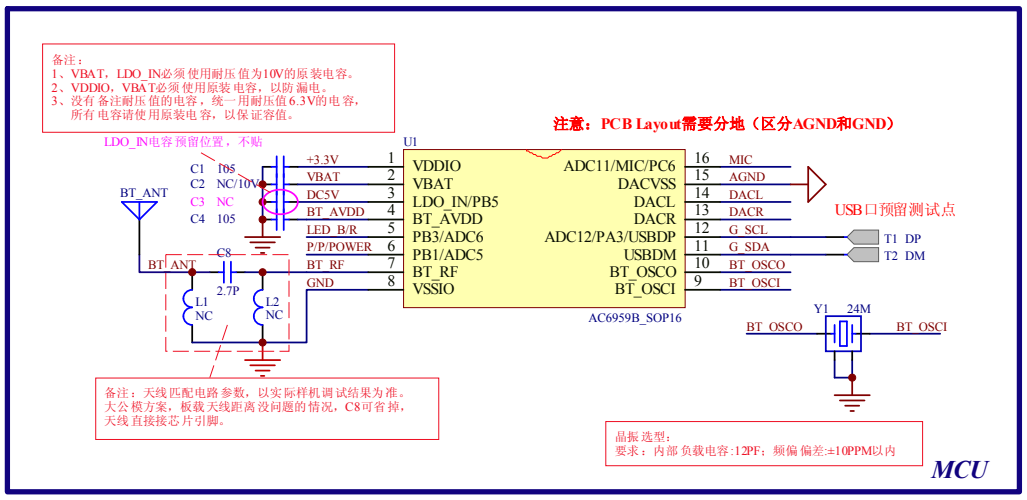
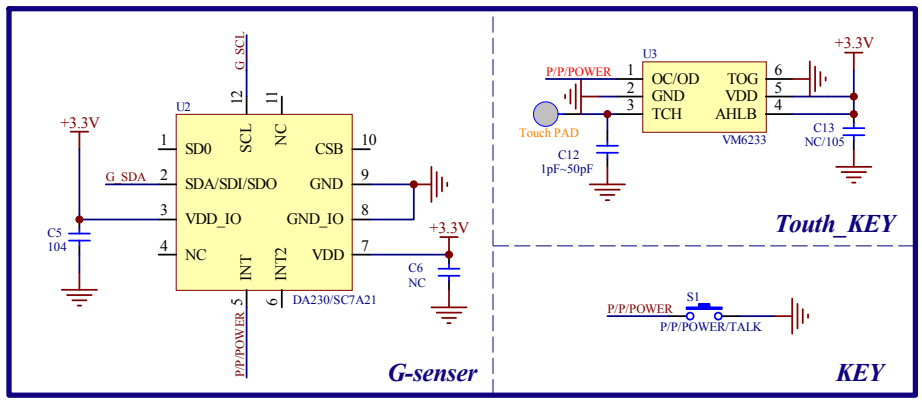
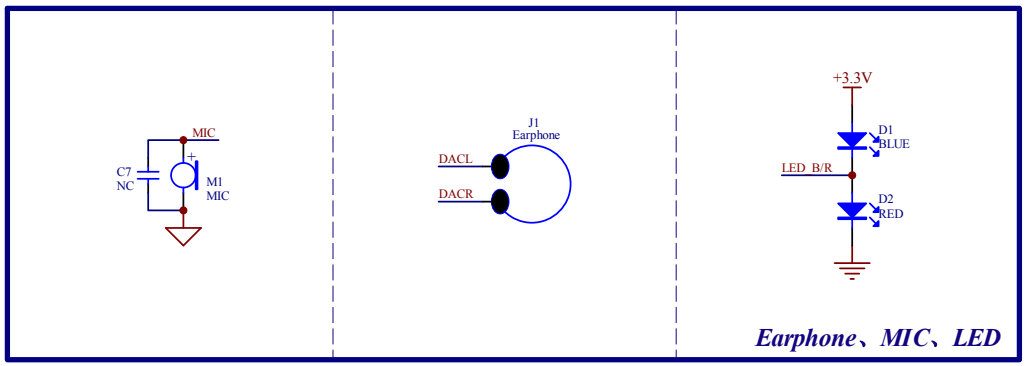
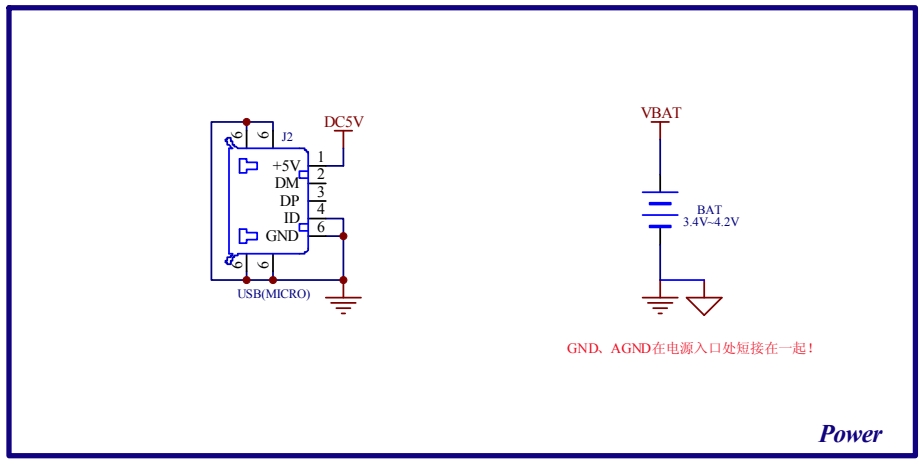

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
LDO_IN电容预留位置，不贴
U1
VDDIO
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB3/ADC6
PB1/ADC5
BT_RF
VSSIO
ADC11/MIC/PC6
DACVSS
DACL
DACR
ADC12/PA3/USBDP
USBDM
BT_OSCO
BT_OSCI
AC6959B_SOP16
MIC
AGND
G_SCL
G_SDA
BT_OSCO
BT_OSCI
USB口预留测试点
T1 DP
T2 DM
Y1 24M
BT_ANT
C1 105
C2 NC/10V
C3 NC
C4 105
C8
2.7P
L1 NC
L2 NC
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
大公模方案，板载天线距离没问题的情况，C8可省掉，
天线直接接芯片引脚。
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差:±10PPM以内
MCU


U2
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
SCL
INT
NC
INT2
CSB
GND
GND_IO
VDD
DA230/SC7A21
G_SCL
G_SDA
P/P/POWER
+3.3V
C5 104
C6 NC
G-senser
U3
OC/OD
GND
TCH
TOG
VDD
AHLB
VM6233
Touch PAD
C12 1pF~50pF
C13 NC/105
Touth_KEY
P/P/POWER
S1
P/P/POWER/TALK
KEY


MIC
C7 NC
M1 MIC
J1 Earphone
DACL
DACR
+3.3V
D1 BLUE
D2 RED
LED_B/R
Earphone、MIC、LED


J2
DC5V
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BAT 3.4V~4.2V
GND、AGND在电源入口处短接在一起！
Power